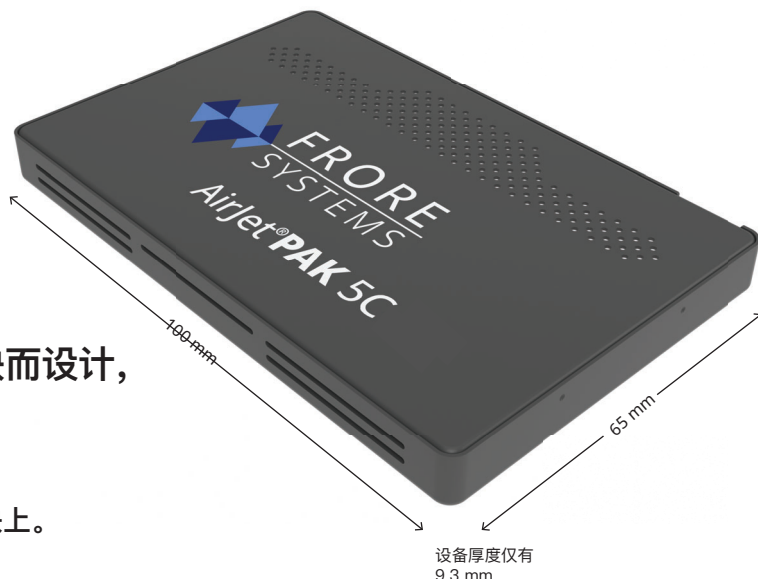




AirJet® PAK 5C

专为配合英伟达Jetson Orin 等 AI 系统级模块而设计，以释放 AI 性能。

- 完全独立、即插即用的散热解决方案
内含多个 AirJet 芯片及驱动电路。
- 可直接安装在类似 NVIDIA Jetson Orin 的 AI 系统级模块上。
- 自主运行。
- 轻薄、静音、无振动、防尘且防水。
- 在 NVIDIA Jetson 平台上，最高支持 100 TOPS 的算力。
- 在环境温度 25°C、结温 115°C 的条件下，最高可散发 34 瓦的热量。



在计算领域，热量是最大的瓶颈，而散热则是如今计算领域中唯一仍在沿用的属于上个世纪的技术。为了满足人工智能所需要的大规模处理，要大幅改进散热技术的需求正在迅速增长。此外，据预测，到 2030 年，对边缘人工智能的需求预计将增长超过 300%，并且短期内这种需求并不会减缓。

AirJet PAK 是全球首款针对边缘 AI 的固态主动散热解决方案，它采用了革命性的**AirJet** 固态主动散热芯片。**AirJet PAK 5C** 是一款完全集成一体化完全独立的主动式散热器模块。

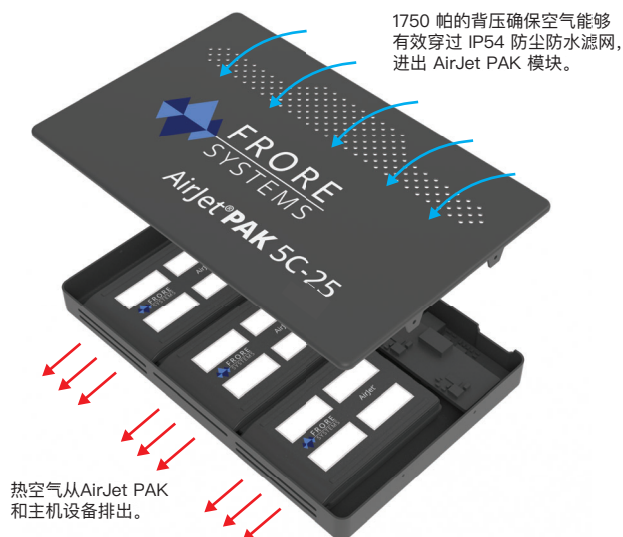
强劲散热能力——**AirJet PAK 5C** 在 25°C 环境温度下集成到工业计算平台中时，能够以 29 dBA 的静音水平散出 34 瓦的净热量，同时最大功耗仅 6.5 瓦，其性能超越了紧凑型边缘 AI 设备中的风扇散热器。

释放 AI 性能——**AirJet PAK 5C** 厚度仅为 9.3 毫米，专为与 NVIDIA Jetson Orin 等 AI 系统级模块无缝协作而设计。这种超薄外形为制造商开辟了新的可能性，满足客户对设备的需求——在更紧凑、静音、无振动、防尘且防水的前提下实现更高性能。

AirJet PAK	NVIDIA Jetson	TOPS	Power
AirJet PAK 5C	Orin NX 16GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	100	27 W
2x AirJet PAK 5C	AGX Orin 64 GB (@ 25°C ambient, Tj 95°C)	250	54 W

每个 AirJet PAK 5C 模组均内置 5 块 AirJet 芯片
—— 全球首款固态主动散热芯片。

指标	AirJet® PAK 5C
总净散热量 (环境温度 25°C，结温 115°C 的条件下)	34 W
最大噪音 (距离 50 厘米处)	29 dBA
最大功耗	6.5 W
输入电压	12 V
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 × 长 × 厚)	100 x 65 x 9.3 mm
重量	100 g



AirJet® PAK 5C

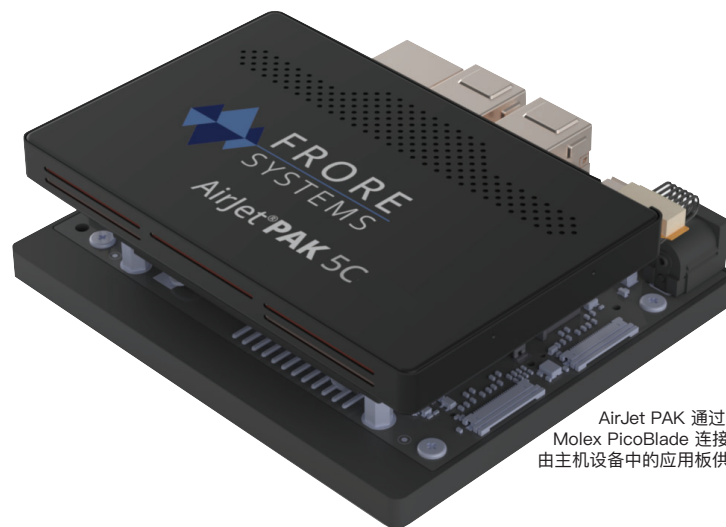
持续稳定的性能与可靠性

AirJet PAK 可产生 1750 帕的背压，即使通风口被 IP54 防尘防水过滤器覆盖，也能确保空气有效进出模块。结合 **AirJet PAK** 的智能自清洁功能，进一步提升了可靠性，确保其散热性能持续稳定，从而使具备防尘功能的主机设备也能保持高性能运行。

AirJet PAK 通过自主驱动力，运用热感技术（Thermoception）独立感知周围温度。这一创新技术让 **AirJet PAK** 无需依赖主机设备内的温度传感器，就能优化自身性能，实现高效散热。**AirJet PAK** 只需从主机设备获取额定电源，就能助力处理器发挥卓越性能。

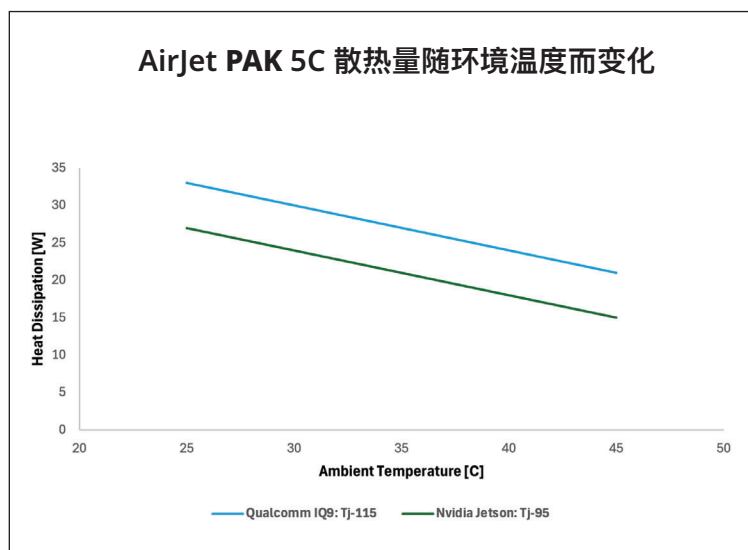
在如今的设备中，决定性能的往往不只是处理器的先进程度，散热解决方案的能力同样至关重要。

得益于 **AirJet PAK 5C**，紧凑型边缘人工智能电子设备
如今终于能够兑现尖端人工智能技术的承诺。**实现更多。**



AirJet PAK 通过 6 针 Molex PicoBlade 连接器, 由主机设备中的应用板供电。

设计用于与 NVIDIA Jetson Orin Industrial 和 Smart City 等 AI 系统级模块无缝协作。



AirJet PAK 模块在主机设备内部的横截面。

